

芯联集成电路制造股份有限公司

2025 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计 2025 年年度实现营业收入约为 81.90 亿元，与上年同期相比增加约 16.81 亿元，同比增长约 25.83%。

（2）预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润约 -5.77 亿元，与上年同期相比减亏约 3.85 亿元，同比减亏约 40.02%。

（3）预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 -10.94 亿元，与上年同期相比减亏约 3.16 亿元，同比减亏约 22.41%。

（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

- (1) 营业收入: 65.09 亿元。
- (2) 归属于母公司所有者的净利润: -9.62 亿元。
- (3) 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润: -14.10 亿元。

三、本期业绩变化的主要原因

2025 年全球半导体行业在技术迭代、需求提升、场景渗透的多重驱动下，呈现出多领域协同发展，新兴应用场景不断拓展的总体发展趋势。随着国内半导体行业技术水平的不断提升，国产替代化进程快速推进，市场份额实现逐步提高。

(一) 公司营收与毛利率持续增长，构建多元增长格局

在市场需求、国产替代、政策支持的共同推动下，公司始终保持较高的产能利用率；通过技术创新和迭代、客户拓展和合作深入，提高产品及服务的价值和竞争力，推动了公司四大应用领域收入的快速增长，构建了车载领域收入领航增长、工业控制与高端消费领域收入稳健发力，AI 应用领域持续渗透的多元增长格局。从晶圆代工到提供系统解决方案，公司一站式系统代工平台的商业模式效能逐步释放，报告期内营业收入预计增长约 25.83%。

随着整体营收规模扩大，规模效应显现，生产精细化运营有效提升，折旧摊销等固定成本逐步摊薄；叠加产品结构的不断优化和升级，公司毛利率预计达到 5.92%，同比提升约 4.89 个百分点，持续保持增长态势。

（二）并购重组整合优化管理，提升运营效率与盈利能力

报告期内，公司通过并购重组等资本市场工具，实现了经营决策、内部管理等方面的深度协同；在公司管理效率、资金管理、销售管理等方面实现了管控优化，期间费用率逐步降低；在保持相当规模研发投入的基础上，公司运营效率持续提升，核心竞争力和盈利能力不断增强。

四、风险提示

截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日